

# 2017-2022年中国集成电路 封装市场调查与发展前景预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2017-2022年中国集成电路封装市场调查与发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/B88477ZW4D.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件（如晶体管）的密度这个角度上来说，IC代表了电子学的尖端。但是IC又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大多数电子系统的基础。同样，IC不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，IC的种类千差万别（模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等），因而对于封装的需求和要求也各不相同。本文对IC封装技术做了全面的回顾，以粗线条的方式介绍了制造这些不可缺少的封装结构时用到的各种材料和工艺。

集成电路封装行业是从集成电路产业中独立出来的子行业。一般来说，集成电路先要进行电路设计、然后再交给芯片制造厂进行制造，接下来则是由专门的封装厂进行后续的封装并对集成电路的电气性能进行测试，最后再在电子产品生产上进行整机组装。封装是集成电路制造过程中的后道工艺，主要是为芯片制造厂生产出来的芯片加上触点、引脚等，使之能够与PCB板这样的外部电路相连接。同时，也为芯片提供了一个保护壳与散热通路，能够防止其受到化学与物理损坏。

集成电路封装行业的发展以芯片封装技术的进步为核心，以适应终端电子产品的轻薄化与小型化为宗旨，封装面积随着工艺的改进与新品面积越来越接近。

对集成电路封装行业来说，其在电子领域的地位不可忽视。在我国集成电路产业整体较为薄弱的背景下，集成电路封装产业也成了我国提振集成电路产业的重要组成部分。尽管我国集成电路封装行业起步较晚，但是由于发展速度较快，目前其技术已经与国际水平相差无几。目前全球集成电路封装行业的市场规模不断扩大，目前已经达到200亿美元。

2020年全球封测市场预测（单位：百万美元）

并且，受到我国政策的影响，集成电路封装产业也将会保持了较高的增长率。并且，我国本土的封装企业在加速全球并购的同时，也为行业带来了大量的只是产权与封装技术，逐渐获得国际客户的青睐。并且，国际封装巨头也不断在我国进行投资，更是为我国集成电路封装产业增添了活力。

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国集成电路封装市场调查与发展前景预测报告》共八章。首先介绍了集成电路封装行业市场发展环境、集成电路封装整体运行态势等，接着分析了集成电路封装行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路封装市场竞争格局。随后，报告对集成电路封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路封装行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报

告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业发展背景 15

1.1 集成电路封装行业定义及分类 15

1.1.1 集成电路封装行业定义 15

1.1.2 集成电路封装行业产品大类 15

1.1.3 集成电路封装行业特性分析 16

(1) 行业周期性 16

(2) 行业区域性 16

(3) 行业季节性 16

1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 17

1.2 集成电路封装行业政策环境分析 18

1.2.1 行业管理体制 18

1.2.2 行业相关政策 18

1.3 集成电路封装行业经济环境分析 19

1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析 19

(1) 国际宏观经济现状 19

(2) 国际宏观经济环境对行业影响分析 22

1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析 22

(1) GDP增长情况分析 22

(2) 居民收入水平 24

1.4 集成电路封装行业技术环境分析 25

1.4.1 集成电路封装技术演进分析 25

1.4.2 集成电路封装形式应用领域 26

1.4.3 集成电路封装工艺流程分析 26

1.4.4 集成电路封装行业新技术动态 27

## 第2章：中国集成电路产业发展分析 29

### 2.1 集成电路产业发展状况 29

近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现了快速发展。报告期内，中国集成电路行业市场增速明显高于全球水平。2013年以来，集成电路行业受国家政策支持力度加大和市场需求形势趋好推动，整体复苏态势强劲，产销增长加快，效益大幅提升，国内产业实力进一步增强，对提高我国电子信息产业核心竞争力进一步发挥积极作用。根据中国半导体行业协会统计，2013年、2014年和2015年，中国集成电路产业销售额分别为2,508.5亿元、3,015.4亿元和3,609.8亿元，2014年和2015年的增长率分别为20.2%和19.7%。受到国内“中国制造2025”、“互联网+”等的带动，以及外资企业加大在华投资影响，2015年中国集成电路产业保持高速增长。

2013-2015年国内集成电路产业销售额及增长率分析（单位：亿元）

#### 2.1.1 集成电路产业链简介 29

集成电路产业链包括设计、制造、封装和测试等环节，各个环节目前已分别发展成为独立、成熟的子行业。按照一般产品购销关系划分的上下游关系，晶圆代工厂商、封装和测试厂商接受集成电路设计企业委托，按照产品方案向集成电路设计企业提供芯片制造、封装和测试服务，集成电路制造、封装和测试行业为集成电路设计行业上游；集成电路设计厂商将芯片产成品销售给电子设备制造厂商，电子设备制造行业为集成电路设计行业下游。

#### 2.1.2 集成电路产业发展现状分析 29

- (1) 行业发展势头良好 29
- (2) 行业技术水平快速提升 30
- (3) 行业竞争力仍有待加强 30
- (4) 产业结构进一步优化 31

#### 2.1.3 集成电路产业区域发展格局分析 31

- (1) 三大区域集聚发展格局业已形成 31
- (2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征 33
- (3) 产业整体将“有聚有分，东进西移” 33

#### 2.1.4 集成电路产业面临的发展机遇 34

- (1) 产业政策环境进一步向好 35

(2) 战略性新兴产业将加速发展 35

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会 35

#### 2.1.5 集成电路产业面临的主要问题 35

(1) 规模小 35

(2) 创新不足 35

(3) 价值链整合不够 36

(4) 产业链不完善 36

#### 2.1.6 集成电路产业“十三五”发展预测 36

#### 2.2 集成电路设计业发展状况 36

受益于市场需求的不断增长、国家产业政策的推动、集成电路设计企业能力的提升，集成电路设计行业整体呈现良好的发展势头。在集成电路设计、制造、封测等细分领域中，集成电路设计行业增速最快。2013年、2014年和2015年，中国集成电路设计产业销售额分别为808.8亿元、1,047.4亿元和1,325亿元，2014年和2015年的增长率分别为29.5%和26.5%。

2013-2015年国内集成电路设计产业销售额及增长率分析（单位：亿元）

##### 2.2.1 集成电路设计业发展概况 36

##### 2.2.2 集成电路设计业发展特征 37

(1) 产业规模持续扩大 37

(2) 质量上升数量下降 38

(3) 企业规模持续扩大 38

(4) 技术能力大幅提升 38

##### 2.2.3 集成电路设计业发展隐忧 39

##### 2.2.4 集成电路设计业新发展策略 39

##### 2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测 39

#### 2.3 集成电路制造业发展状况 40

##### 2.3.1 集成电路制造业发展现状分析 40

(1) 集成电路制造业发展总体概况 40

(2) 集成电路制造业发展主要特点 40

(3) 集成电路制造业规模及财务指标分析 41

1) 集成电路制造业规模分析 41

2) 集成电路制造业盈利能力分析 41

3) 集成电路制造业运营能力分析 42

- 4) 集成电路制造业偿债能力分析 42
- 5) 集成电路制造业发展能力分析 43
- 2.3.2 集成电路制造业经济指标分析 43
  - (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素 43
  - (2) 集成电路制造业经济指标分析 44
  - (3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析 45
  - (4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析 47
  - (5) 不同地区企业经济指标分析 49
- 2.3.3 集成电路制造业供需平衡分析 60
  - (1) 全国集成电路制造业供给情况分析 60
    - 1) 全国集成电路制造业总产值分析 60
    - 2) 全国集成电路制造业产成品分析 61
  - (2) 全国集成电路制造业需求情况分析 61
    - 1) 全国集成电路制造业销售产值分析 61
    - 2) 全国集成电路制造业销售收入分析 62
  - (3) 全国集成电路制造业产销率分析 63
- 2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测 63

### 第3章：中国集成电路封装行业发展分析 64

- 3.1 中国集成电路封装行业整体发展情况 64
  - 3.1.1 集成电路封装行业规模分析 64
  - 3.1.2 集成电路封装行业发展现状分析 64
  - 3.1.3 集成电路封装行业利润水平分析 65
  - 3.1.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较 66
  - 3.1.5 集成电路封装行业影响因素分析 66
    - (1) 有利因素 66
    - (2) 不利因素 67
  - 3.1.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测 68
    - (1) 发展趋势分析 68
    - (2) 前景预测 69
- 3.2 半导体封测发展情况分析 70
  - 3.2.1 半导体行业发展概况 70

- 3.2.2 半导体行业景气预测 70
- 3.2.3 半导体封装发展分析 72
  - (1) 封装环节产值逐年成长 73
  - (2) 封装环节外包是未来发展趋势 73
- 3.3 集成电路封装类专利分析 74
  - 3.3.1 专利分析样本构成 74
    - (1) 数据库选择 74
    - (2) 检索方式 74
  - 3.3.2 专利发展情况分析 75
    - (1) 专利申请数量趋势 75
    - (2) 专利公开数量趋势 76
    - (3) 技术类型情况分析 77
    - (4) 技术分类趋势分布 77
    - (5) 主要权利人分布情况 78
  - 3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨 79
    - 3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策 79
      - (1) 封装开裂的影响因素分析 79
      - (2) 管控影响开裂的因素的方法分析 81
    - 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 81
      - (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析 81
      - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法 82

#### 第4章：中国集成电路封装行业市场需求分析 85

- 4.1 集成电路市场分析 85
  - 4.1.1 集成电路市场规模 85
  - 4.1.2 集成电路市场结构分析 85
    - (1) 集成电路市场产品结构分析 85
    - (2) 集成电路市场应用结构分析 86
  - 4.1.3 集成电路市场竞争格局 87
  - 4.1.4 集成电路国内市场自给率 87
  - 4.1.5 集成电路市场发展预测 88
- 4.2 集成电路封装行业需求分析 88

- 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析 88
  - (1) 计算机市场发展现状 88
  - (2) 集成电路在计算机领域的应用 89
  - (3) 计算机领域对行业需求的拉动 89
- 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析 90
  - (1) 消费电子市场发展现状 90
  - (2) 消费电子领域对行业需求的拉动 93
- 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析 93
  - (1) 通信设备市场发展现状 93
  - (2) 集成电路在通信设备领域的应用 95
  - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动 96
- 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析 96
  - (1) 工控设备市场发展现状 97
  - (2) 集成电路在工控设备领域的应用 97
  - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动 97
- 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析 97
  - (1) 汽车电子市场发展现状 97
  - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用 99
  - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动 99
- 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析 99

## 第5章：集成电路封装行业市场竞争分析 103

- 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析 103
  - 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况 103
  - 5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析 103
  - 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析 104
    - (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本 104
    - (2) 主板材料的变化趋势 107
  - 5.1.4 跨国企业在华市场竞争力分析 108
    - (1) 台湾日月光集团竞争力分析 108
      - 1) 企业发展简介 108
      - 2) 企业经营情况分析 108

- 3) 企业主营产品及应用领域 109
- 4) 企业市场区域及行业地位分析 109
- 5) 企业在中国市场投资布局情况 109
- (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析 110
  - 1) 企业发展简介 110
  - 2) 企业经营情况分析 110
  - 3) 企业主营产品及应用领域 110
  - 4) 企业市场区域及行业地位分析 110
  - 5) 企业在中国市场投资布局情况 110
- (3) 台湾矽品公司竞争力分析 110
  - 1) 企业发展简介 110
  - 2) 企业经营情况分析 111
  - 3) 企业主营产品及应用领域 111
  - 4) 企业市场区域及行业地位分析 112
  - 5) 企业在中国市场投资布局情况 112
- (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析 112
  - 1) 企业发展简介 112
  - 2) 企业经营情况分析 112
  - 3) 企业主营产品及应用领域 112
  - 4) 企业市场区域及行业地位分析 113
  - 5) 企业在中国市场投资布局情况 113
- (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析 113
  - 1) 企业发展简介 113
  - 2) 企业经营情况分析 113
  - 3) 企业主营产品及应用领域 113
  - 4) 企业市场区域及行业地位分析 113
  - 5) 企业在中国市场投资布局情况 114
- (6) 飞思卡尔公司竞争力分析 114
  - 1) 企业发展简介 114
  - 2) 企业经营情况分析 114
  - 3) 企业主营产品及应用领域 114
  - 4) 企业市场区域及行业地位分析 114

- 5) 企业在中国市场投资布局情况 115
  - (7) 英飞凌科技公司竞争力分析 115
- 1) 企业发展简介 115
- 2) 企业经营情况分析 115
- 3) 企业主营产品及应用领域 115
- 4) 企业市场区域及行业地位分析 115
- 5) 企业在中国市场投资布局情况 115
- 5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析 116
  - 5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析 116
  - 5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析 117
- 5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 117
  - 5.3.1 现有竞争者之间的竞争 117
  - 5.3.2 上游议价能力分析 118
  - 5.3.3 下游议价能力分析 119
  - 5.3.4 行业潜在进入者分析 119
  - 5.3.5 替代品风险分析 120
  - 5.3.6 行业竞争五力模型总结 120

## 第6章：中国集成电路封装行业产品市场分析 122

- 6.1 集成电路封装行业BGA产品市场分析 122
  - 6.1.1 BGA封装技术 122
  - 6.1.2 BGA产品主要应用领域 123
  - 6.1.3 BGA产品需求拉动因素 124
  - 6.1.4 BGA产品市场应用现状分析 125
  - 6.1.5 BGA产品市场前景展望 125
- 6.2 集成电路封装行业SIP产品市场分析 126
  - 6.2.1 SIP封装技术 126
  - 6.2.2 SIP产品主要应用领域 126
  - 6.2.3 SIP产品需求拉动因素 127
  - 6.2.4 SIP产品市场应用现状分析 127
  - 6.2.5 SIP产品市场前景展望 128
- 6.3 集成电路封装行业SOP产品市场分析 129

6.3.1 SOP封装技术	129
6.3.2 SOP产品主要应用领域	130
6.3.3 SOP产品市场发展现状	130
6.3.4 SOP产品市场前景展望	131
6.4 集成电路封装行业QFP产品市场分析	131
6.4.1 QFP封装技术	131
6.4.2 QFP产品主要应用领域	132
6.4.3 QFP产品市场发展现状	132
6.4.4 QFP产品市场前景展望	132
6.5 集成电路封装行业QFN产品市场分析	132
6.5.1 QFN封装技术	132
6.5.2 QFN产品主要应用领域	133
6.5.3 QFN产品市场发展现状	133
6.5.4 QFN产品市场前景展望	134
6.6 集成电路封装行业MCM产品市场分析	134
6.6.1 MCM封装技术水平概况	134
(1) 概念简介	134
(2) MCM封装分类	134
6.6.2 MCM产品主要应用领域	135
6.6.3 MCM产品需求拉动因素	135
6.6.4 MCM产品市场发展现状	136
6.6.5 MCM产品市场前景展望	136
6.7 集成电路封装行业CSP产品市场分析	137
6.7.1 CSP封装技术水平概况	137
(1) 概念简介	137
(2) CSP产品特点	138
(3) CSP封装分类	138
6.7.2 CSP产品主要应用领域	139
6.7.3 CSP产品市场发展现状	139
6.7.4 CSP产品市场前景展望	140
6.8 集成电路封装行业其他产品市场分析	140
6.8.1 晶圆级封装市场分析	140

- (1) 概念简介 140
- (2) 产品特点 141
- (3) 主要应用领域 141
- (4) 市场规模与主要供应商 142
- (5) 前景展望 142

#### 6.8.2 覆晶/倒封装市场分析 143

- (1) 概念简介 143
- (2) 产品特点 143
- (3) 市场前景 143

#### 6.8.3 3D封装市场分析 143

- (1) 概念简介 143
- (2) 封装方法 143
- (3) 封装特点 144
- (4) 发展现状与前景 145

### 第7章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析 146

#### 7.1 集成电路封装企业发展总体状况分析 146

##### 7.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名 146

##### 7.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名 146

#### 7.2 集成电路封装行业领先企业个案分析 147

##### 7.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析 147

- (1) 企业发展简况分析 147
- (2) 企业产销能力分析 148
- (3) 企业盈利能力分析 148
- (4) 企业运营能力分析 149
- (5) 企业偿债能力分析 149
- (6) 企业发展能力分析 150
- (7) 企业产品结构及新产品动向 150
- (8) 企业销售渠道与网络 150
- (9) 企业经营状况优劣势分析 150

##### 7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析 151

- (1) 企业发展简况分析 151

- (2) 企业产销能力分析 151
- (3) 企业盈利能力分析 152
- (4) 企业运营能力分析 152
- (5) 企业偿债能力分析 153
- (6) 企业发展能力分析 153
- (7) 企业产品结构及新产品动向 154
- (8) 企业销售渠道与网络 154
- (9) 企业经营状况优劣势分析 154

#### 7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 154

- (1) 企业发展简况分析 154
- (2) 主要经济指标分析 155
- (3) 企业盈利能力分析 156
- (4) 企业运营能力分析 156
- (5) 企业偿债能力分析 157
- (6) 企业发展能力分析 157
- (7) 企业组织架构分析 158
- (8) 企业产品结构及新产品动向 158
- (9) 企业销售渠道与网络 159
- (10) 企业经营状况优劣势分析 160
- (11) 企业投资兼并与重组分析 160
- (12) 企业最新发展动向分析 161

#### 7.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析 161

- (1) 企业发展简况分析 161
- (2) 企业产销能力分析 161
- (3) 企业盈利能力分析 162
- (4) 企业运营能力分析 162
- (5) 企业偿债能力分析 163
- (6) 企业发展能力分析 163
- (7) 企业产品结构及新产品动向 164
- (8) 企业销售渠道与网络 164
- (9) 企业经营状况优劣势分析 164

#### 7.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析 164

- (1) 企业发展简况分析 164
  - (2) 企业产销能力分析 165
  - (3) 企业盈利能力分析 165
  - (4) 企业运营能力分析 166
  - (5) 企业偿债能力分析 166
  - (6) 企业发展能力分析 167
  - (7) 企业产品结构及新产品动向 167
  - (8) 企业销售渠道与网络 167
  - (9) 企业经营状况优劣势分析 168
- &hellip;&hellip;另有23家企业分析

## 第8章：中国集成电路封装行业投资分析及建议 253 (ZY LII)

### 8.1 集成电路封装行业投资特性分析 253

#### 8.1.1 集成电路封装行业进入壁垒 253

- (1) 技术壁垒 253
- (2) 资金壁垒 253
- (3) 人才壁垒 253
- (4) 严格的客户认证制度 253

#### 8.1.2 集成电路封装行业盈利模式 254

#### 8.1.3 集成电路封装行业盈利因素 254

### 8.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析 255

#### 8.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况 255

#### 8.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 255

#### 8.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析 257

- (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析 257
- (2) 华天科技公司投资兼并与重组分析 258
- (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析 259

#### 8.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析 260

### 8.3 集成电路封装行业投融资分析 260

#### 8.3.1 电子发展基金对集成电路产业的扶持分析 260

- (1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况 260
- (2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议 261

8.3.2 集成电路封装行业融资成本分析 262

8.3.3 半导体行业资本支出分析 262

8.4 集成电路封装行业投资建议 263

8.4.1 集成电路封装行业投资机会分析 263

8.4.2 集成电路封装行业投资风险分析 264

8.4.3 集成电路封装行业投资建议 267

(1) 投资区域建议 267

(2) 投资产品建议 267

(3) 技术升级建议 268 (ZY LII)

图表目录：

图表1：集成电路封装行业产品分类 15

图表2：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%） 16

图表3：2016年10月江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元） 17

图表4：2011年以来集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%） 17

图表5：集成电路封装行业主要政策分析 18

图表6：2016年10月发达经济体增长情况（单位：%） 19

图表7：2016年10月主要新兴经济体增长情况（单位：%） 20

图表8：2016年10月主要国家1季度经济增长速度（单位：%） 21

图表9：2016年10月世界银行和IMF对于世界主要经济体的预测（单位：%） 22

图表10：2013-2016年10月中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 23

图表11：2012年以来中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%） 23

图表12：2013-2016年10月我国城镇居民人均可支配收入及其变化趋势（单位：元，%） 24

图表13：2013-2016年10月我国农村居民纯收入及其变化趋势（单位：元，%） 24

图表14：封装技术的演进 25

图表15：各种集成电路封装形式应用领域 26

图表16：集成电路封装工艺流程 26

图表17：集成电路产业链示意图 29

图表18：2016年10月中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿块，亿美元，%） 30

图表19：2016年10月我国集成电路产业结构（单位：%） 31

图表20：中国集成电路产业长三角地区分布概况 32

图表21：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析 34

- 图表22：2013-2016年10月我国集成电路设计市场销售额走势（单位：亿元） 37
- 图表23：集成电路设计业新发展策略 39
- 图表24：集成电路制造业发展主要特点分析 40
- 图表25：2013-2016年10月中国集成电路制造业规模分析（单位：家，人，万元） 41
- 图表26：2013-2016年10月中国集成电路制造业盈利能力分析（单位：%） 42
- 图表27：2013-2016年10月中国集成电路制造业运营能力分析（单位：次） 42
- 图表28：2013-2016年10月中国集成电路制造业偿债能力分析（单位：% ，倍） 43
- 图表29：2013-2016年10月中国集成电路制造业发展能力分析（单位：%） 43
- 图表30：2013-2016年10月中国集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 44

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/B88477ZW4D.html>